

JP 2004 118880 A 2004.4.15

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-118880

(P2004-118880A)

(43) 公開日 平成16年4月15日(2004.4.15)

(51) Int. Cl.⁷

G11B 7/26

F1

G11B 7/26 521

テーマコード(参考)

5D121

審査請求 未請求 請求項の数 14 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2002-276491 (P2002-276491)
 (22) 出願日 平成14年9月24日(2002.9.24)

(71) 出願人 000003067
 TDK株式会社
 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
 (74) 代理人 100104787
 弁理士 酒井 伸司
 (72) 発明者 宇佐美 守
 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ
 ィーディーケイ株式会社内
 (72) 発明者 井出 順一
 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ
 ィーディーケイ株式会社内
 (72) 発明者 山口 晴彦
 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テ
 ィーディーケイ株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置

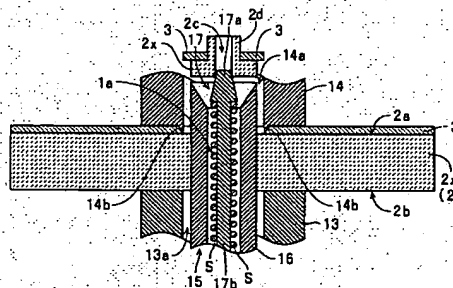
(57) 【要約】

【課題】製造コストの低減を図りつつ、中心孔近傍における樹脂層の剥離およびバリの発生を回避し得る光記録媒体の製造方法を提供する。

【解決手段】基材2×の表面2aに樹脂層3を形成した後に基材2×および樹脂層3を連通する中心孔1aを形成して光記録媒体を製造する光記録媒体の製造方法であって、中心孔1aの形成部位を取り囲むようにして中心孔1aよりも大径かつ円形状の切込みを樹脂層3に形成した後に、基材2×の裏面2b側から中心孔形成用の打抜き用刃部15を基材2×に押し込んで中心孔1aを形成する。

【選択図】

図1.2



(2)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ディスク状基材の一方の面に樹脂層を形成した後に当該ディスク状基材および当該樹脂層を連通する中心孔を形成して光記録媒体を製造する光記録媒体の製造方法であって、前記中心孔の形成部位を取り囲むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から前記中心孔形成用の打抜き用刃部を当該ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する光記録媒体の製造方法。

【請求項 2】

前記一方の面に達する深さの前記切込みを前記樹脂層に形成する請求項 1 記載の光記録媒体の製造方法。 10

【請求項 3】

前記ディスク状基材の前記他方の面に基材押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ前記樹脂層に前記切込みを形成する請求項 1 または 2 記載の光記録媒体の製造方法。

【請求項 4】

前記樹脂層に樹脂層押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ前記ディスク状基材に前記打抜き用刃部を押し込んで前記中心孔を形成する請求項 1 から 3 のいずれかに記載の光記録媒体の製造方法。

【請求項 5】

前記切込みの深さに応じた高さの切込み形成用刃部が形成された前記樹脂層押さえ用治具を当該樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成する請求項 4 記載の光記録媒体の製造方法。 20

【請求項 6】

前記打抜き用刃部に超音波による振動を加えつつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する請求項 1 から 5 のいずれかに記載の光記録媒体の製造方法。

【請求項 7】

前記ディスク状基材の成形時に、当該ディスク状基材の前記他方の面における前記中心孔の形成部位に当該中心孔と同径またはほぼ同径の凹部を形成する請求項 1 から 6 のいずれかに記載の光記録媒体の製造方法。 30

【請求項 8】

一方の面に樹脂層が形成されたディスク状基材に当該ディスク状基材および当該樹脂層を連通する中心孔を形成する光記録媒体製造装置であって、前記中心孔の形成部位を取り囲むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成可能な切込み形成用刃部と、前記中心孔形成用の打抜き用刃部と、前記切込み形成用刃部および前記打抜き用刃部の移動を制御する制御部とを備え、当該制御部は、前記樹脂層に向けて前記切込み形成用刃部を移動させて当該樹脂層に当該切込み形成用刃部を押し込んで前記切込みを形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から当該ディスク状基材に向けて前記打抜き用刃部を移動させて押し込んで前記中心孔を形成する光記録媒体製造装置。 40

【請求項 9】

前記切込み形成用刃部は、前記一方の面に達する深さの前記切込みを形成可能に構成されている請求項 8 記載の光記録媒体製造装置。

【請求項 10】

前記切込みの形成時に前記制御部の制御に従って前記ディスク状基材の前記他方の面を押さえる基材押さえ用治具を備え、前記制御部は、前記基材押さえ用治具を前記ディスク状基材の前記他方の面に当接させ、その状態を維持しつつ前記切込み形成用刃部を移動させて前記切込みを形成する請求項 8 または 9 記載の光記録媒体製造装置。

【請求項 11】

50

(3)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

前記中心孔の形成時に前記制御部の制御に従って前記樹脂層を押さえる樹脂層押さえ用治具を備え、

前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させ、その状態を維持しつつ前記打抜き用刃部を移動させて前記中心孔を形成する請求項8から10のいずれかに記載の光記録媒体製造装置。

【請求項12】

前記樹脂層押さえ用治具は、前記切込みの深さに応じた高さの前記切込み形成用刃部を備えて構成され、

前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成する請求項11記載の光記録媒体製造装置。

【請求項13】

前記打抜き用刃部に超音波による振動を加える超音波発生部を備え、

前記制御部は、前記超音波発生部に対して前記打抜き用刃部に前記超音波による振動を加えさせつつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する請求項8から12のいずれかに記載の光記録媒体製造装置。

【請求項14】

前記ディスク状基材における前記中心孔の形成部位の中心に形成された位置決め用孔に合可能に形成されると共に弾性変形部を介して前記打抜き用刃部の中央に取り付けられて当該打抜き用刃部の刃先よりも突出せられた位置決め用凸部を備えている請求項8から13のいずれかに記載の光記録媒体製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ディスク状基材の一方の面に樹脂層を形成した後にディスク状基材および樹脂層を連通する中心孔を形成する光記録媒体の製造方法、およびその光記録媒体の製造方法に従って光記録媒体を製造可能に構成された光記録媒体製造装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

CDやDVD等の光ディスク（光記録媒体）の製造に際しては、一般的に、射出成形によってその表面にグルーブやランドが形成された円板状（ディスク状）の基材にスパッタ法等によって光反射層などの薄膜を形成した後に、この薄膜を覆うようにして保護層（カバー層）としての樹脂層をスピンコート法によって形成する。また、CD-R、CD-RW、DVD-RおよびDVD-RW等の書き込み可能な光ディスクの製造に際しては、基材の表面にスパッタ法等によって記録層や光反射層などの薄膜を順に形成した後に、この薄膜を覆うようにして保護層としての樹脂層をスピンコート法によって形成する。この際に、完成状態の光ディスクにおける樹脂層の膜厚にはばらつきが生じた場合、記録データの正常な読み書きが困難となる。したがって、樹脂層の形成に際しては、樹脂層形成用の樹脂材料を基材全面に亘って均一な膜厚にスピンコートする必要がある。また、スピンコート法によって基材上に均一な膜厚の樹脂層を形成するためには、回転状態の基材の中心に樹脂材料を滴下するのが好ましい。しかし、光ディスクの中心には、記録再生装置等にクランプ（チャッキング）させるための中心孔を設ける必要があるため、スピンコートに際して基材の中心に樹脂材料を滴下するのが困難となっている。このため、出願人は、中心孔の形成に先立って基材に樹脂材料を滴下して均一な膜厚の樹脂層を形成した後に、基材および樹脂層を連通するようにして中心孔を打抜き形成する光ディスクの製造方法を開発している。

【0003】

具体的には、図14に示すように、その中心部に中心孔が形成されていない円板状の基材52における表面52aに樹脂材料をスピンコートする。この際には、同図に破線で示すように、塗布装置によって回転させられている基材52の中心（後に中心孔が形成される部位）に例えば紫外線硬化型の樹脂材料を滴下して、回転に伴う遠心力によって基材52

(4)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

の外縁部に向けて樹脂材料を拡げる。この際に、基材52の回転数を適宜調節することにより、基材52の全面に亘って樹脂材料を均一に塗布することができ、次に、基材52上の樹脂材料に対して紫外線を照射することによって樹脂材料を硬化させて樹脂層53を形成する。次いで、中心孔51aを形成するための円筒状の打抜き用刃部65を裏面52b側から矢印Aの向きで基材52に押し込んで同図に破線で示す部位を打ち抜く。これにより、図15に示すように、基材52および樹脂層53を連通するようにして直径L1が15mm程度を中心孔51aが形成されて、光ディスク51が完成する。

【0004】

一方、特開平10-289489号公報には、基板(10)に形成されている中心孔(10h)を閉塞板(21)によって閉塞した状態において光硬化性樹脂を滴下して光透過層(18)を形成する光学記録媒体の製造方法が開示されている。この製造方法では、基板の製造に際して中心孔の周辺部に凹部(20)を形成すると共に、光硬化性樹脂を滴下する際には、この凹部に閉塞板をめ込むことによって合体基板を形成して中心孔を閉塞する。これにより、基板の中心部(この場合、閉塞板の中心部)に光硬化性樹脂を滴下することが可能となっている。また、基板の中心部に滴下した光硬化性樹脂を延伸させて光硬化させた後には、中心孔打ち抜き機(71)によって閉塞板および光透過層を打ち抜いて中心孔を形成する。これにより、光学記録媒体が製造される。

【0005】

【特許文献1】

特開平10-289489号公報(第3-4頁)

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、この光ディスク51の製造方法には、以下の改善すべき課題がある。すなわち、この製造方法では、中心孔が形成されていない基材52に均一な膜厚の樹脂層53を形成した後、中心孔51aを打ち抜いている。この場合、基材52上に形成された樹脂層53は、その厚みが100μmと非常に薄厚となっている。このため、中心孔51aの形成に際して裏面52bから基材52に打抜き用刃部65を押し込んだときに、図16に示すように、中心孔51aの形成部位近傍において樹脂層53が基材52から剝離するおそれがある。また、中心孔51aの形成に際して打抜き用刃部65によって薄厚の樹脂層53を綺麗に打ち抜くのが困難のため、打ち抜かれた中心孔51aの口縁部にバリが発生するおそれもある。さらに、中心孔51aの形成に際して樹脂層53が剝離しなかったとしても、その光ディスク51を記録再生装置等にクランプさせる際に、記録再生装置によって中心孔51aの口縁が擦られて樹脂層53が基材52から剝離するおそれもある。

【0007】

一方、特開平10-289489号公報に開示されている光学記録媒体(光記録媒体)の製造方法では、光透過層の形成面側から中心孔打ち抜き機で打ち抜いて中心孔を形成している。この方法によれば、光透過層の剝離を回避することが可能となるものの、上記した光ディスク51の製造方法と同様に、打ち抜かれた中心孔の口縁部にバリが発生するおそれがある。また、この光学記録媒体の製造方法では、基板と閉塞板とを別個に成形すると共に、光硬化性樹脂の滴下に際して凹部に閉塞板をめ込まねばならず、光記録媒体の製造コストが高騰しているという問題点がある。

【0008】

本発明は、かかる改善すべき課題に鑑みてなされたものであり、製造コストの低減を図りつつ、中心孔近傍における樹脂層の剝離およびバリの発生を回避し得る光記録媒体の製造方法並びに光記録媒体製造装置を提供することを主目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明に係る光記録媒体の製造方法は、ディスク状基材の一方の面に樹脂層を形成した後、当該ディスク状基材および当該樹脂層を連通する中心孔を形成して光記録媒体を製造する光記録媒体の製造方法であって、前記中心孔の形成部位を取り囲

(5)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から前記中心孔形成用の打抜き用刃部を当該ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成する。

【0010】

この場合、前記一方の面に達する深さの前記切込みを前記樹脂層に形成するのが好ましい。

【0011】

また、前記ディスク状基材の前記他方の面に基材押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ前記樹脂層に前記切込みを形成するのが好ましい。

【0012】

さらに、前記樹脂層に樹脂層押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ前記ディスク状基材に前記打抜き用刃部を押し込んで前記中心孔を形成するのが好ましい。

【0013】

また、前記切込みの深さに応じた高さの切込み形成用刃部が形成された前記樹脂層押さえ用治具を当該樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成するのが好ましい。

【0014】

さらに、前記打抜き用刃部に超音波による振動を加えつつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成するのが好ましい。

【0015】

また、前記ディスク状基材の成形時に、当該ディスク状基材の前記他方の面における前記中心孔の形成部位に当該中心孔と同径またはほぼ同径の凹部を形成するのが好ましい。

【0016】

また、本発明に係る光記録媒体製造装置は、一方の面に樹脂層が形成されたディスク状基材に当該ディスク状基材および当該樹脂層を連通する中心孔を形成する光記録媒体製造装置であって、前記中心孔の形成部位を取り囲むようにして当該中心孔よりも大径かつ円形状の切込みを前記樹脂層に形成可能な切込み形成用刃部と、前記中心孔形成用の打抜き用刃部と、前記切込み形成用刃部および前記打抜き用刃部の移動を制御する制御部とを備え、当該制御部は、前記樹脂層に向けて前記切込み形成用刃部を移動させて当該樹脂層に当該切込み形成用刃部を押し込んで前記切込みを形成した後に、前記ディスク状基材の他方の面側から当該ディスク状基材に向けて前記打抜き用刃部を移動させて押し込んで前記中心孔を形成する。

【0017】

この場合、前記切込み形成用刃部は、前記一方の面に達する深さの前記切込みを形成可能に構成されているのが好ましい。

【0018】

また、前記切込みの形成時に前記制御部の制御に従って前記ディスク状基材の前記他方の面を押さえる基材押さえ用治具を備え、前記制御部は、前記基材押さえ用治具を前記ディスク状基材の前記他方の面に当接させ、その状態を維持しつつ前記切込み形成用刃部を移動させて前記切込みを形成するのが好ましい。

【0019】

さらに、前記中心孔の形成時に前記制御部の制御に従って前記樹脂層を押さえる樹脂層押さえ用治具を備え、前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させ、その状態を維持しつつ前記打抜き用刃部を移動させて前記中心孔を形成するのが好ましい。

【0020】

また、前記樹脂層押さえ用治具は、前記切込みの深さに応じた高さの前記切込み形成用刃部を備えて構成され、前記制御部は、前記樹脂層押さえ用治具を前記樹脂層に当接させることによって当該樹脂層に前記切込みを形成するのが好ましい。

【0021】

さらに、前記打抜き用刃部に超音波による振動を加える超音波発生部を備え、前記制御部

10

20

30

40

50

(6)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

は、前記超音波発生部に対して前記打抜き用刃部に前記超音波による振動を加えさせつつ当該打抜き用刃部を前記ディスク状基材に押し込んで前記中心孔を形成するのが好ましい。

【0022】

また、前記ディスク状基材における前記中心孔の形成部位の中心に形成された位置決め用孔に合可能に形成されると共に弾性変形部を介して前記打抜き用刃部の中央に取り付けられて当該打抜き用刃部の刃先よりも突出させられた位置決め用凸部を備えているのが好ましい。

【0023】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置の好適な実施の形態について説明する。

【0024】

最初に、本発明に係る光記録媒体の製造方法に従って製造された光ディスク1、および光ディスク1を製造するための製造装置11の構成について、図面を参照して説明する。

【0025】

図1に示す光ディスク1は、本発明における光記録媒体に相当し、円板状のディスク状基材（以下、「基材」ともいう）2の一方の面に光反射層等の薄膜（図示せず）が形成されると共に、その薄膜を覆うようにして樹脂層3が形成されて構成されている。なお、本発明についての理解を容易とするため、光反射層等の構成および形成方法等についての説明を省略する。また、この光ディスク1には、記録再生装置等にクランプさせるための中心孔1aが形成されている。

【0026】

基材2は、光ディスク1の製造に先立ってポリカーボネイト等の樹脂材料で射出成形される。なお、以下の説明において、完成状態における光ディスク1の基材2と、射出成形直後の基材2とを区別するために、射出成形直後の基材2（中心孔1aが形成されていない状態の基材2）を基材2xともいう。この場合、図2に示すように、基材2xの表面2aには、射出成形によってグループやランドが形成され、表面2aの中央部には、位置決め用の連通孔2c（本発明における位置決め用孔）が形成された円筒状の突起部2dが形成されている。さらに、図7に示すように、裏面2bの中央部には、後にその底面が打ち抜かれることによって中心孔1aを構成する凹部2eが形成されている。この場合、凹部2eの直径L2は、一例として、中心孔1aの直径L1（図13参照）と等しい（同等の）1.5mmに形成されている。また、連通孔2cは、その直径L3が一例として5mmで、その中心が凹部2eの中心と一致するように形成されている。樹脂層3は、基材2上に形成された薄膜（光反射層や記録層など）を保護するための保護層（カバー層）であって、一例として紫外線硬化型の樹脂材料がスピンコート法によって塗布されてその厚みT1（図13参照）が100μm程度となるように形成されている。

【0027】

一方、図3に示す製造装置11は、本発明に係る光記録媒体製造装置に相当し、上下動機構12a~12c、押さえ用治具13、14、打抜き用刃部15、超音波発生部18および制御部19を備えている。上下動機構12a~12cは、制御部19の制御下で押さえ用治具13、14および打抜き用刃部15を上下動させる。押さえ用治具13は、本発明における基材押さえ用治具に相当し、図4に示すように、打抜き用刃部15を挿通させるための挿通用孔13aが中央部に形成されると共に、上面が平坦に形成されて全体として円筒状に形成されている。この場合、挿通用孔13aの直径L5aは、一例として16mm程度に規定されている。押さえ用治具14は、本発明における樹脂層押さえ用治具に相当し、図5に示すように、中心孔1aの形成時に打抜き用刃部15によって打ち抜かれた打抜き片を挿通させるための挿通用孔14aが中央部に形成されて全体として円筒状に形成されている。また、押さえ用治具14の下面（同図における上面）は、平坦に形成されると共に、挿通用孔14aの口縁部には、切込み形成用刃部14bが形成されている。こ

(7)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

の場合、挿通孔 14a の直径 L5b (すなわち、切込み形成用刃部 14b の内径) は、中心孔 1a の直径 L1 よりも大径の 1.6 mm 程度に規定されている。また、切込み形成用刃部 14b の高さ H1 は、光ディスク 1 の製造に際して樹脂層 3 に形成する切込みの深さに応じて樹脂層 3 の厚み T1 よりも若干高い 1.05 μ m 程度に規定されている。

【0028】

打抜き用刃部 15 は、図 6 に示すように、円筒状の刃部本体 16、円錐台形状の位置決め用凸部 17、およびコイルスプリング 8 (図 10 参照) を備えている。刃部本体 16 は、その直径 (外径) L6 が中心孔 1a の直径 L1 と同等の 1.5 mm に規定されると共に、位置決め用凸部 17 を挿通させるための挿通孔 16a が中央部に形成されて円筒状に形成されている。位置決め用凸部 17 は、刃部本体 16 による中心孔 1a の形成 (打抜き) に際して基材 2x における連通孔 2c の口縁部に当接させられる側面視台形状の当接部 17a と、当接部 17a の下方に一体的に連結されてその周囲にコイルスプリング 8 が配設されるシャフト 17b とを備えている。この場合、位置決め用凸部 17 は、当接部 17a における上端部側の直径 L7 が基材 2x の連通孔 2c よりも小径 (一例として 4 mm 程度) に規定されると共に、その下端部側の直径 L8 が連通孔 2c よりも大径 (一例として 6 mm 程度) に形成されている。また、位置決め用凸部 17 は、刃部本体 16 に対して上下動可能に取り付けられ、当接部 17a が刃部本体 16 の上端部から突出するようにコイルスプリング 8 によって上向きに付勢されている。

【0029】

超音波発生部 18 は、制御部 19 の制御下で超音波を発生させて打抜き用刃部 15 の刃部本体 16 に伝達することによって刃部本体 16 を振動させる。制御部 19 は、上下動機構 12a ~ 12c および超音波発生部 18 の動作を制御する。なお、本発明についての理解を容易とするために、基材 2x に対して樹脂材料をスピンコートする塗布装置の構成および塗布方法についての図示および説明を省略する。

【0030】

次に、光ディスク 1 の製造方法について、図面を参照して説明する。なお、基材 2x の射出成形、および基材 2x の表面 2a に対する薄膜の形成については、既に完了しているものとする。

【0031】

まず、基材 2x の表面 2a に樹脂材料をスピンコートする。この際には、塗布装置に基材 2x をセットした状態で基材 2x を回転させると共に、表面 2a に樹脂材料を滴下する。この際に、図 7 に破線で示すように、突起部 2d の外壁近傍に樹脂材料を滴下することにより、出願人が開発している従来のスピンコート方法 (中心孔が形成されていない基材の中心部に樹脂材料を滴下する方法) と同様にして樹脂材料を均一な膜厚に拡げることができ、次に、基材 2x の回転数を適宜調節することにより、回転に伴う遠心力によって表面 2a 全体に樹脂材料を均一に拡げる。次いで、この状態の基材 2x に対して紫外線を照射することによって樹脂材料を硬化させる。これにより、同図に示すように、基材 2x の表面 2a に均一な膜厚の樹脂層 3 が形成される。

【0032】

次に、樹脂層 3 が形成された基材 2x に中心孔 1a を形成する。この際に、制御部 19 は、まず、上下動機構 12a に対して押さえ用治具 13 を上動させることにより、図 8 に示すように、基材 2x の裏面 2b に押さえ用治具 13 を当接させる。次いで、図 9 に示すように、制御部 19 は、上下動機構 12b に対して押さえ用治具 14 を下動させることにより、切込み形成用刃部 14b を樹脂層 3 に押し込ませる。この場合、切込み形成用刃部 14b が樹脂層 3 の厚み T1 よりも若干高い高さ H1 に形成されているため、上下動機構 12b によって押さえ用治具 14 の下面が樹脂層 3 の表面に当接させられることにより、切込み形成用刃部 14b の刃先が基材 2x の表面 2a に到達する。これにより、樹脂層 3 に切込み形成用刃部 14b の直径 L5b (この場合、1.6 mm) と等しい円形の切込みが形成される。

【0033】

(8)

JP 2004-118880 A 2004.4.15

続いて、制御部 19 は、上下動機構 12a、12b に対して押さえ用治具 13、14 を基材 2× にそれぞれ当接させ、その状態を維持させつつ、上下動機構 12c に対して打抜き用刃部 15 を上動させる。同時に、制御部 19 は、超音波発生部 18 に対して超音波を発生させて刃部本体 16 を振動させる。この際には、図 10 に示すように、まず、位置決め用凸部 17 の当接部 17a が基材 2× の凹部 2e 内における連通孔 2c の口縁部に当接（合）させられる。この場合、打抜き用刃部 15 の中心と基材 2× の中心（すなわち、連通孔 2c の中心）とが位置ずれしていたとしても、当接部 17a の上端部が連通孔 2c に合することにより、打抜き用刃部 15 が基材 2× に対して移動させられて、打抜き用刃部 15 の中心と基材 2× の中心とが一致させられる。次に、上下動機構 12c によって打抜き用刃部 15 がさらに上動させられることにより、刃部本体 16 が凹部 2e の底面に当接させられ、さらに上動させられることにより、図 11 に示すように、刃部本体 16 の刃先が基材 2× に押し込まれる。この際に、超音波発生部 18 によって刃部本体 16 が超音波によって振動させられているため、基材 2× に刃部本体 16 をスムーズに押し込むことができる。

【0034】

この後、打抜き用刃部 15 がさらに上動させられて、刃部本体 16 の刃先が基材 2× の表面 2a に達した際に、図 12 に示すように、突起部 2d 近傍の基材 2× が打ち抜かれて中心孔 1a が形成される。この際に、切込み形成用刃部 14b によって樹脂層 3 に切込みが形成されているため、刃部本体 16 の刃先が表面 2a に達した時点において、刃部本体 16 が上動させられる力によって押さえ用治具 14 における切込み形成用刃部 14b の内側の樹脂層 3 が基材 2× の表面 2a（中心孔 1a の口縁部）から引き剥がされる。これにより、図 13 に示すように、その直径 L4 が中心孔 1a の直径 L1 よりも大径（この場合、切込み形成用刃部 14b の直径 L5b と同等の 1.6mm）の孔 3a が樹脂層 3 に形成されて光ディスク 1 が完成する。

【0035】

このように、この光ディスク 1 の製造方法および製造装置 11 によれば、押さえ用治具 14 の切込み形成用刃部 14b によって中心孔 1a の形成部位を取り囲むようにして中心孔 1a よりも大径かつ円形状の切込みを樹脂層 3 に形成した後に、基材 2× の裏面 2b 側から打抜き用刃部 15 の刃部本体 16 を押し込んで中心孔 1a を打抜き形成することにより、基材 2× に刃部本体 16 を押し込んで中心孔 1a を形成する際に、基材 2× の表面 2a からの樹脂層 3 の剥離を回避することができ、また、製造後の光ディスク 1 における樹脂層 3 には、その直径 L4 が中心孔 1a の直径 L1 よりも大径の孔 3a が形成されているため、この光ディスク 1 を記録再生装置にクランプさせる際に樹脂層 3（孔 3a の口縁部）に対する擦れを回避することができ、クランプ時における樹脂層 3 の剥離を回避することができる。さらに、樹脂層 3 に切込みを予め形成しておくことにより、中心孔 1a の打抜き形成時における樹脂層 3 でのバリの発生を回避することができる。この場合、切込み形成用刃部 14b によって基材 2× の表面 2a に達する深さの切込みを形成することにより、中心孔 1a の打抜き形成時における樹脂層 3 の剥離をより確実に回避することができる。また、この光ディスク 1 の製造方法および製造装置 11 によれば、基材 2× の裏面 2b に押さえ用治具 13 を当接させ、その状態を維持しつつ樹脂層 3 に切込み形成用刃部 14b を押し込んで切込みを形成することにより、切込み形成用刃部 14b を樹脂層 3 に押し込んだ際に基材 2× のみを回避することができ、切込み形成用刃部 14b の刃先を基材 2× の表面 2a に当接させることで樹脂層 3 を確実に切断することができる。

【0036】

さらに、この光ディスク 1 の製造方法および製造装置 11 によれば、樹脂層 3 に押さえ用治具 14 を当接させ、その状態を維持しつつ基材 2× に刃部本体 16 を押し込んで中心孔 1a を形成することにより、刃部本体 16 を基材 2× に押し込んだ際の基材 2× のみを回避することができ、基材 2× のみに起因する基材 2× の破損や樹脂層 3 の剥離を回避することができる。また、押さえ用治具 14 によって樹脂層 3 における孔 3a の口

JP 2004 118880 A 2004.4.15

10

..20

30

50

(10)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

ことができる。この場合、切込み形成用刃部によって基材の表面（一方の面）に達する深さの切込みを形成することにより、中心孔の打抜き形成時における樹脂層の剝離をより確実に回避することができる。また、製造後の光記録媒体における樹脂層には、その直径が中心孔の直径よりも大径の孔が形成されているため、この光記録媒体を記録再生装置にクランプさせる際に樹脂層（孔の口縁部）に対する擦れを回避することができる結果、クランプ時における樹脂層の剝離を回避することができる。さらに、樹脂層に切込みを予め形成しておくことにより、中心孔の打抜き形成時における樹脂層でのバリの発生を回避することができる。

【0040】

また、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、ディスク状基材の他方の面に基材押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつ樹脂層に切込みを形成することにより、切込み形成用刃部を樹脂層に押し込んだ際にディスク状基材の

10

【0041】

さらに、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、樹脂層に樹脂層押さえ用治具を当接させ、その状態を維持しつつディスク状基材に打抜き用刃部を押し込んで中心孔を形成することにより、打抜き用刃部をディスク状基材に押し込んだ際のディスク状基材の

20

【0042】

また、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、切込みの深さに応じた高さの切込み形成用刃部が形成された樹脂層押さえ用治具を樹脂層に当接させて樹脂層に切込みを形成することにより、専用の切込み形成用刃部によって切込みを形成した後、その切込み形成用刃部を待避させて、樹脂層押さえ専用の押さえ用治具を樹脂層に当接させる方法と比較して、樹脂層押さえ用治具を樹脂層に当接させるだけで切込み形成用刃部で切込みを形成することができると共に、その状態で樹脂層を押さえつつ打抜き用刃部を押し込むことができる。このため、ディスク状基材の破損等を回避しつつ、

30

【0043】

さらに、本発明に係る光記録媒体の製造方法および光記録媒体製造装置によれば、打抜き用刃部を超音波によって振動させつつ打抜き用刃部をディスク状基材に押し込んで中心孔を形成することにより、打抜き用刃部をディスク状基材にスムーズに押し込むことができ

【0044】

また、本発明に係る光記録媒体の製造方法によれば、ディスク状基材の成形時に、ディスク状基材の他方の面における中心孔の形成部位に中心孔と同径またはほぼ同径の凹部を形成したことにより、凹部が形成されていない基材に打抜き用刃部を押し込んで中心孔を形成する方法と比較して、打抜き用刃部で打ち抜く基材を薄厚に形成することができるため、中心孔を容易に形成することができる。この場合、凹部を中心孔の直径と同等の直径に形成したことにより、凹部の内壁面を打抜き用刃部のガイドとして機能させることができる結果、中心孔が偏心した状態で形成されるのを回避することができる。

40

【0045】

さらに、本発明に係る光記録媒体製造装置によれば、ディスク状基材の中心に形成された位置決め用孔に合可能に形成されると共に弾性変形部を介して打抜き用刃部の中央に取り付けられて打抜き用刃部の刃先よりも突出させられた位置決め用凸部を備えたことにより、位置決め用凸部が打抜き用刃部に先立って位置決め用孔の口縁部に当接して打抜き用刃部の中心とディスク状基材の中心とを一致させるため、偏心した状態での中心孔の形成

50

(11)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

を確実に回避することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の実施の形態に係る光ディスク 1 の外観斜視図である。

【図 2】光ディスク 1 用の基材 2×の外観斜視図である。

【図 3】製造装置 11 の構成を示すブロック図である。

【図 4】製造装置 11 における押さえ用治具 13 の外観斜視図である。

【図 5】製造装置 11 における押さえ用治具 14 の外観斜視図である。

【図 6】製造装置 11 における打抜き用刃部 15 の外観斜視図である。

【図 7】基材 2×上に樹脂層 3 を形成した状態の断面図である。

【図 8】基材 2×の裏面に押さえ用治具 13 を当接させた状態の断面図である。

10

【図 9】樹脂層 3 に押さえ用治具 14 を当接させて切込みを形成した状態の断面図である。

【図 10】基材 2×における連通孔 2c の口縁に位置決め用凸部 17 が当接させられた状態の断面図である。

【図 11】打抜き用刃部 15 の刃部本体 16 を凹部 2e の底面に押し込んだ状態の断面図である。

【図 12】刃部本体 16 によって中心孔 1a を打ち抜いた状態の断面図である。

【図 13】光ディスク 1 の断面図である。

【図 14】従来の光ディスク 51 の製造に際して基材 52 上に樹脂層 53 を形成した状態の断面図である。

20

【図 15】光ディスク 51 の断面図である。

【図 16】樹脂層 53 の中心孔 51a 近傍が基材 52 から剥離した状態の断面図である。

【符号の説明】

1 光ディスク

1a 中心孔

2, 2× 基材

2a 表面

2b 裏面

2c 連通孔

2d 突起部

2e 凹部

3 樹脂層

3a 孔

11 製造装置

12a~12c 上下動機構

13 押さえ用治具

14 押さえ用治具

14b 切込み形成用刃部

15 打抜き用刃部

16 刃部本体

17 位置決め用凸部

18 超音波発生部

19 制御部

H1 高さ

L1~L8 直径

S コイルスプリング

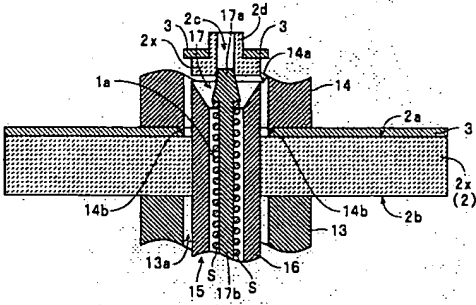
T1 厚み

30

40

(13) JP 2004 118880 A 2004. 4. 15

【図 12】



(14)

JP 2004 118880 A 2004.4.15

フロントページの続き

(72)発明者 丑田 智樹

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 5D121 AA02 DD13 DD17 GG24 GG28